

可焊性实验报告
SOLDERABILITY TEST

公司料号 Factory P/N	客户料号 Customer P/N	客户 Customer
	Accessory part	0
试验项目 Item	◆ 喷锡板 HAL ◇ 金板 Plating Gold ◇ 沉锡 Immersion Tin	

试验条件 Condition

温度 Temperature	260±5℃	时间 Time	5秒1次 5second / once
检查内容 Contents	检查结果 Results		
1. 浸润 Wettability	ACC		
2. 爆孔 Hole Void	ACC		
3. 绿油起泡 Solder Mask Blister	ACC		
4. 铜皮起泡 Copper-cold Blister	ACC		
5. 翘曲度 Warp-Twist	ACC		
6. 基材状况 Status of Laminate	ACC		
备注 Note:			
结论 Conclusion:			
◆ ACC ◇ REJ ◇ UAI			
Inspected By 检验员	Date 日期	Approved By 审核	Date 日期